

香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明并明确表示概不就因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。



SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION

中芯国际集成电路制造有限公司*

(于开曼群岛注册成立之有限公司)

(股份代号: 0981)

中芯截至二零零八年十二月三十一日止三个月业绩公布

- 国际主要半导体代工制造商中芯国际集成电路制造有限公司(纽约交易所: SMI; 香港联交所: 981)([中芯]或[本公司])于今日公布截至二零零八年十二月三十一日止三个月的综合经营业绩。
- 二零零八年第四季的销售总额与二零零八年第三季相比下降 27.5%至 272,500,000 元主要是由于晶圆出货量下降 25.1%。针对 2008 年全年,非记忆体晶圆销售额录得年度增幅 14.3%,来自中国区的销售收入录得年度增幅 28.0%。二零零八年第四季的毛利率为-27.4%,而二零零八年第三季的毛利率为 7.2%主要由于产能利用率大幅下降。二零零八年第四季录得净亏损 124,500,000 元,二零零八年第三季录得净亏损 30,300,000 元。二零零八年第四季来自于经营活动的净现金流由二零零八年第三季的 110,100,000 元增加至 171,200,000 元是由于营运资金使用有所改善。来自于经营活动的现金减去资本开支的净额由二零零八年第三季的-120,600,000 元改善至 23,700,000 元。由于于二零零八年第四季引入战略投资人的新股本资金以及贷款的偿还,公司的债务股本比率由二零零八年第三季的 45.7%下降至 39.7%。二零零八年第四季的简化平均销售价格为 843 元录得季度降幅 3.2%,年度增幅 6.0%。2008 年全年简化平均销售价格为 840 元,2007 年全年简化平均销售价格为 838 元。
- 以下为本公司于二零零九年二月五日就截至二零零八年十二月三十一日止三个月的未经审核业绩公布全文。
- 本公司根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第 13.09(1)条规定的披露责任于二零零九年二月五日作出本公布。

以下为本公司于二零零九年二月五日就截至二零零八年十二月三十一日止三个月的未经审核业绩公布全文。

所有货币数字主要以美元列账,除非特别指明。

报告内的财务报表数额按美国公认会计原则厘定。

中国上海—二零零九年二月五日—国际主要半导体代工制造商中芯国际集成电路制造有限公司（纽约交易所：SMI；香港联交所：981）（「中芯」或「本公司」）于今日公布截至二零零八年十二月三十一日止三个月的综合经营业绩。

二零零八年第四季概要

- 二零零八年第四季的总销售额与二零零八年第三季相比下降 27.5%至 272,500,000 元主要是由于晶圆出货量下降 25.1%。
- 针对 2008 年全年，非记忆体晶圆销售额录得年度增幅 14.3%，来自中国区的销售收入录得年度增幅 28.0%。
- 二零零八年第四季的毛利率为-27.4%，而二零零八年第三季的毛利率为 7.2%主要由于产能利用率大幅下降。
- 二零零八年第四季录得净亏损 124,500,000 元，二零零八年第三季录得净亏损 30,300,000 元。
- 二零零八年第四季来自于经营活动的净现金流由二零零八年第三季的 110,100,000 元增加至 171,200,000 元是由于营运资金使用有所改善。来自于经营活动的现金减去资本开支的净额由二零零八年第三季的-120,600,000 元改善至 23,700,000 元。
- 由于于二零零八年第四季引入战略投资人的新股本资金以及贷款的偿还，公司的债务股本比率由二零零八年第三季的 45.7%下降至 39.7%。
- 二零零八年第四季的简化平均销售价格为 843 元录得季度降幅 3.2%，年度增幅 6.0%。2008 年全年简化平均销售价格为 840 元，2007 年全年简化平均销售价格为 838 元。

中芯国际首席执行官张汝京博士就本季度的运营成果发表评论：「尽管我们于 2008 年第四季度的表现受到全球经济形势所影响，我们仍能实现较早前所作出的营收预测。2008 年，虽然遭遇到第四季度的困难经济环境，我们仍成功将非 DRAM 收入按年增加 14.3%，符合我们将重点放在非 DRAM 业务的战略。此外，凭借我们于中国市场的实力，我们 2008 年本土 IC 公司销售的营收比 2007 年增加了 28%。

展望未来，我们将继续以捕捉中国市场的发展机遇为主要战略。我们期望中国政府正在实施的众多刺激经济政策，如最近发行的 3G（“第三代”）移动通信牌照。将带动本土市场以及基础设施的需求。中芯国际提供给中国及全球客户的完善技术及优良往绩有助我们抓住中国的 3G 机会。为了成就我们以中国市场为主的战略，我们与大唐——我国移动通信技术的领导者，形成了战略伙伴关系。我们期望这一合作使中芯国际成为大唐 TD-SCDMA——我国的本土 3G 无线标准，主要的芯片供货商。我们致力与世界一流的合作伙伴为不同的客户提供更好的服务，以提高我们在中国市场的领导地位。目前，我们已经为我们的中国客户生产 CIS，CMMB 制式移动电视，高清电视，RFID 和 LCOS 产品，我们希望继续加强我们的产品组合。

2008年，在中芯国际进行投片生产的客户较上一年增长16%。在2008年第四季度，新投片生产量按增长了9%，我们期望2009年第一季度的投片生产量将保持强劲势头。在我们的先进技术发展方面，我们成功提前45纳米硅片的进度，以及为我们的客户发布了三套自主设计的65纳米标准单元库。我们北京厂把DRAM产能转换成逻辑产能也已完成，现在北京厂每月8吋晶圆的总产能为40,500片。

此外，我们继续加强我们的资产负债表。我们过往数年的EBITDA(未计利息、税项、折旧及摊销前的利润)一直保持着正数，而我们预计这情况将于2009年继续。由于减少了使用营运资金以及加强了控制资本支出，我们于扣除资本开支后经营业务现金流量从2008年第三季度的负1亿2千1百万美元增加至2008年第四季度的2千4百万美元。由于大唐新股权资金的流入加上债务的偿还，截至去年第四季度，我们的债务权益比率已由第三季度末的45.7%下降至39.7%。并且我们在这经济下滑的环境中实行严格的资本支出和费用控制。预计2009年的资本支出将约为1亿9千万美元，比2008年下降约72%。此外，我们订立目标在毋需裁减员工的情况下降低2009年的总薪金支出15%。我们感谢我们的员工在此困难时刻的支持。

在目前的营商环境下，我们计划继续把重心放在维持良好的客户关系、加强我们的产品组合、专注于大中华市场发展，同时继续发展先进的技术和降低成本，务求使我们在全球经济复苏的时候于半导体代工行业中成为一个更强大和更具竞争力的参与者。

电话会议 / 网上业绩公布详情

日期：二零零九年二月六日

时间：上海时间上午八时三十分

拨号及登入密码：美国 1-617-597-5342 (密码：SMIC) 或香港 852-3002-1672 (密码：SMIC)。

二零零八年第四季业绩公布网上直播可于 www.smics.com 网站「投资者关系」一栏收听。中芯网站在网上广播后为期十二个月提供网上广播录音版本连同本新闻发布的软拷贝。

关于中芯

中芯国际集成电路制造有限公司(“中芯国际”，纽约证交所股票代码:SMI，香港联合交易所股票代码:981)，是世界领先的集成电路芯片代工企业之一，也是中国内地规模最大、技术最先进的集成电路芯片代工企业。中芯国际向全球客户提供0.35微米到45纳米芯片代工与技术服务。中芯国际总部位于上海，在上海建有一座300mm芯片厂和三座200mm芯片厂。在北京建有两座300mm芯片厂，在天津建有一座200mm芯片厂，在深圳有一座200mm芯片厂在兴建中，在成都拥有一座封装测试厂。中芯国际还在美国、欧洲、日本提供客户服务和设立营销办事处，同时在香港设立了代表处。此外，中芯代成都成芯半导体制造有限公司经营管理一座200mm芯片厂，也代武汉新芯集成电路制造有限公司经营管理一座300mm芯片厂。

详细信息请参考中芯国际网站<http://www.smics.com>

安全港声明

(根据 1995 私人有价证券诉讼改革法案)

本次新闻发布可能载有(除历史资料外)依据 1995 美国私人有价证券诉讼改革法案的“安全港”条文所界定的「前瞻性陈述」。该等前瞻性陈述,包括中芯国际继续抓住在中国发展机遇的能力,中国经济相对全球经济恢复较快,中芯国际成为大唐 TD-SCDMA 芯片技术主要供应商的期望,中芯国际继续加强产品组合,中芯国际在 2009 年第一季度投片生产量保持强劲势头的期望,中芯国际于 2009 年保持着正数 EBITDA(未计利息、税项、折旧及摊销前的利润)的能力,中芯国际在 2009 年资本支出和目标性减少总薪金成本的预期,中芯国际努力将自己定位为一个更强大和更具竞争力的半导体代工行业参与者的预期,以及在随后“折旧与摊销”、“资本概要”和“二零零九年第一季”指引等陈述乃根据中芯对未来事件的现行假设、期望及预测而作出。中芯使用「相信」、「预期」、「计划」、「估计」、「预计」、「预测」及类似表述为该等前瞻性陈述之标识,尽管并非所有前瞻性陈述均包含上述字眼。该等前瞻性陈述乃反映中芯高级管理层根据最佳判断作出的估计,存在重大已知及未知风险、不确定性,以及其它可能导致中芯实际业绩、财政状况或经营结果与前瞻性陈述所载资料存在重大差异的因素,包括(但不限于)与半导体行业周期及市场状况有关的风险、全球经济衰退及其对中国经济的影响、激烈竞争、中芯客户能否及时接收晶圆产品、能否及时引进新技术、中芯国际抓住在中国发展机遇的能力、中芯国际成为大唐 TD-SCDMA 芯片主要供应商的能力、中芯国际继续加强产品组合、半导体代工服务供求情况、行业产能过剩、设备、零件及原材料短缺、制造生产量供给及最终市场的金融局势是否稳定。

投资者应考虑中芯呈交予美国证券交易委员会(「证交会」)的文件资料,包括其于二零零八年十一月二十八日以 20-F 表格形式呈交予证交会的年度报告,特别是「风险因素」及「有关财政状况及经营业绩的管理层讨论及分析」两个部份,以及中芯可能不时向证交会及香港联交所呈交的该等其它文件,包括 6-K 表格。其它未知或不可预知的因素亦可能会对中芯日后的业绩、表现或成就造成重大不利影响。鉴于上述风险、不确定性、假设及因素,本新闻发布中提及的前瞻性事件可能不会发生。务请阁下注意,切勿过份依赖此等前瞻性陈述,此等陈述仅就本新闻发布中所载述日期(或如无有关日期,则为本新闻发布日期)的情况而表述。除法律有所规定以外,中芯概不就因新资料、未来事件或其它原因引起的任何情况承担任何责任,亦不拟更新任何前瞻性陈述。

重大诉讼

台积电法律诉讼之近期发展

于二零零六年八月二十五日，台积电入禀加州阿拉米达郡最高法院，就指称本公司违反和解协议、违反承兑票据及不当使用商业机密而对本公司及若干附属公司（中芯上海、中芯北京及中芯美国）提出诉讼。台积电诉求（其中包括）损害赔偿、禁制令、律师费及提早支付和解协议项下尚未支付之金额。

在当前之诉讼中，台积电指称本公司将台积电之商业机密运用于制造本公司 0.13 微米或更小之工艺产品。台积电进一步称，由于本公司违约，有关台积电的专利授权已予终止，有关本公司较大工艺产品之不起诉承诺亦已失效。

本公司强烈否认所有不当使用之指控。截至目前为止，法院并未认定台积电的指控确属有效。审判日期暂定为二零零九年九月一日。

本公司于二零零六年九月十三日公布，除提出强烈否认台积电在美国诉讼提出的指控外，并已于二零零六年九月十二日反诉台积电，就（其中包括）台积电违反合约及违反默示的善意公平交易的契诺，要求台积电作出损害赔偿。

中华人民共和国北京市高级人民法院于二零零六年十一月十六日受理本公司及本公司的全资子公司中芯上海及中芯北京共同提起的针对台积电违反诚实信用原则、商业诋毁的不公平竞争行为的指控（「中国诉讼」）。在中国诉讼中，本公司寻求（其中包括）判令台积电停止侵权行为、公开向本公司道歉和赔偿损失（包括台积电因其侵权行为所获得的利润）。

台积电于二零零七年一月向美国加州法院动议寻求禁制中国诉讼。于二零零七年二月，台积电向北京市高级人民法院提出司法管辖权的异议，质疑北京市高级人民法院对中国诉讼的司法管辖权限。

二零零七年三月，加州法院驳回台积电有关禁制中国诉讼的声请。台积电就该决定向加州上诉法院提出上诉。二零零八年三月二十六日，加州上诉法院以书面形式驳回台积电的上诉。

二零零七年七月，北京市高级人民法院驳回台积电对中国诉讼的司法管辖权的异议，并认为北京市高级人民法院对该诉讼拥有适当的司法管辖权。台积电就北京市高级人民法院的裁定，向中华人民共和国最高人民法院提出上诉。二零零八年一月七日，最高人民法院就台积电的上诉公开开庭审。二零零八年六月十三日，最高人民法院驳回台积电的上诉，并确认了北京市高级人民法院的司法管辖权。

二零零七年八月十四日，本公司修订对台积电提出的反诉，寻求（其中包括）台积电违约及违反专利授权协议的赔偿。台积电随后否认本公司关于修正反诉的指称，并追加指称本公司于北京市高级人民法院起诉台积电乃违反和解协议。本公司已否认台积电的该追加指称。

二零零七年八月十五日至十七日，美国加州法院就台积电申请临时禁制令寻求禁止本公司制造的 0.13 微米或以下的逻辑技术产品进行庭审。并于二零零七年九月七日作出裁定。该裁定拒绝台积电提出的临时禁制令申请，本公司的业务发展和销售因而得以不受影响。但该裁定要求本公司若计划在某些情况下披露其逻辑技术予非中芯国际的机构时，必须给予台积电十天的通知以让台积电可就该披露提出异议。

于二零零八年三月十一日，台积电在加州法院提出扣押命令的申请。依该申请，台积电寻求确保获取本公司依和解协议及承兑票据尚未支付的余额。本公司反对该项申请。庭审已于二零零八年四月三日召开。二零零八年六月二十四日，法院驳回了台积电的该项申请。

于二零零八年五月，台积电就本公司的多项反诉向加州法院提交请求简易判决的声请。本公司反对该声请，二零零八年八月六日，法院决定部分批准并部分驳回台积电声请。

二零零八年六月二十三日，本公司向加州法院对台积电提出反诉，就（其中包括）台积电非法不当使用本公司的商业机密以提升其对本公司的竞争地位寻求赔偿。

二零零八年七月十日，加州法院就台积电申请临时禁制令欲禁止本公司向第三方披露有关 0.30 微米逻辑技术产品的若干制程配方的资料作出庭审，二零零八年八月八日并决定批准部分该禁制声请，初步限制本公司揭露十四个制程步骤，二零零八年十月三日，本公司就此禁制决定向加州上诉法院上诉。

在审判前的程序进行中，出现双方所签定的和解协议真正条款究竟为何或和解协议是否有效的问题。就目前已揭示的证据来看，本公司认为在本公司二零零五年 20-F 附件中的和解协议并未正确反应双方和解的内容。就此，加州法院于二零零九年一月十三至十六日开庭审理 (a) 是否存在和解协议，如果存在，(b) 和解协议的条款为何；审理结果可能对本公司过去及未来的财务报告、财务状况、及营运结果产生重大影响。

美国法院目前排定，将于二零零九年九月一日开始审理关于台积电所选定商业秘密的诉求及本公司商业秘密的诉求所牵涉的责任问题。

根据美国财务会计准则第 144 号，本公司须决定该未决诉讼是否构成需要进一步分析专利许可组合是否已受损害之事件。我们相信，该法律诉讼现处于早期阶段，我们仍在评估诉讼是否属于该类事件。本公司预期将获得进一步资料以协助我们作出决定。根据美国财务会计准则第 144 号进行之任何损害分析结果可能对本公司财政状况及经营业绩产生重大影响。由于诉讼仍处于早期阶段，本公司未能评估颁布不利判决的可能性或估计潜在亏损的金额或范围。

投资者联络资料：

En-Ling Feng

电话：+86-21-3861-0000，内线：16275

Enling_Feng@smics.com

Beverly Liu

电话: +86-21-3861-0000, 内线: 16099

Beverly_Liu@smics.com

Edith Kwan

电话: +852-2116-2624

Edith_Kwan@smics.com

二零零八年第四季经营业绩概要:

以千美元为单位 (每股盈利和百分比除外)

	二零零八年 第四季度	二零零八年 第三季度	季度比较	二零零七年 第四季度	年度比较
销售收入	272,479	375,945	-27.5%	395,254	-31.1%
销售成本	347,114	348,721	-0.5%	360,207	-3.6%
毛利	(74,635)	27,224	-	35,047	-
经营开支	46,445	40,451	14.8%	57,389	-19.1%
经营亏损	(121,080)	(13,227)	815.4%	(22,342)	441.9%
其它费用, 净额	(4,146)	(15,631)	-73.5%	(1,655)	150.5%
所得税利益 (支出)	(745)	(4,499)	-83.4%	23,100	-
税后净亏损	(125,971)	(33,357)	277.6%	(897)	13943.6%
少数股权	1,520	3,094	-50.9%	1,157	31.4%
应占联营公司亏损	(92)	(26)	253.8%	(882)	-89.5%
普通股持有人应占亏损	(124,543)	(30,289)	311.2%	(622)	19923.0%
毛利率	-27.4%	7.2%		8.9%	
经营利润率	-44.4%	-3.5%		-5.7%	
每股普通股股份净亏损-基本 ⁽¹⁾	(0.0066)	(0.0016)		(0.0000)	
每股美国预托股股份净亏损-基本	(0.3287)	(0.0814)		(0.0017)	
每股普通股股份净亏损-摊薄 ⁽¹⁾	(0.0066)	(0.0016)		(0.0000)	
每股美国预托股股份净亏损-摊薄	(0.3287)	(0.0814)		(0.0017)	
付运晶圆 (8 吋等值) ⁽²⁾	323,175	431,660	-25.1%	497,454	-35.0%
产能使用率	67.7%	90.5%		94.4%	

附注：

(1) 基于二零零八年第四季加权平均普通股 18,948,000,000 股（基本）及 18,948,000,000 股（摊薄），二零零八年第三季 18,612,000,000 股（基本）及 18,612,000,000 股（摊薄），二零零七年第四季 18,550,000,000 股（基本）及 18,550,000,000 股（摊薄）

(2) 包括铜接连线

- 二零零八年第四季总销售额由二零零八年第三季的 375,900,000 元下降至 272,500,000 元，录得季度降幅 27.5%，与二零零七第四季的 395,300,000 元相比录得年度降幅 31.1%是由于晶圆出货量下降所致。
- 二零零八年第四季的销售成本与二零零八年第三季的 348,700,000 元相比，下降 0.5%至 347,100,000 元。
- 二零零八年第四季的毛利与二零零八年第三季的 27,200,000 元相比，减少至负 74,600,000 元，二零零七年第四季的毛利为 35,000,000 元。
- 二零零八年第四季的毛利率由二零零八年第三季 7.2%下降至负 27.4%。主要由于产能使用率大幅下降所致。
- 二零零八年第四季的总经营开支与二零零八年第三季的 40,500,000 元相比，录得季度升幅 14.8%至 46,400,000 元，主要是由于所获技术协议相关无形资产摊销费用增加所致。
- 二零零八年第四季的研发费用与二零零八年第三季的相比，从 17,800,000 元下降 29.8%至 12,500,000 元，主要由于二零零八年第四季政府补助金增加。剔除政府补贴，研发费用录得季度增幅 8.0%主要是由于与 45 纳米和 65 纳米研发活动相关的费用增加所致。
- 二零零八年第四季的一般行政费与二零零八年第三季的 10,800,000 元相比，增加至 16,100,000 元，是由于二零零八年第三季冲销多计提的律师费用、而二零零八年第四季专业费用增加以及坏帐备拨增加所致。
- 二零零八年第四季的销售费用由二零零八年第三季的 5,600,000 元增加至 5,800,000 元，录得季度升幅 4.8%。

收入分析

销售分析			
以应用分类	二零零八年 第四季度	二零零八年 第三季度	二零零七年 第四季度
计算机	4.5%	5.4%	22.9%
通讯	45.9%	53.0%	47.4%
消费	37.5%	32.8%	22.7%
其它	12.1%	8.8%	7.0%
以服务分类	二零零八年 第四季度	二零零八年 第三季度	二零零七年 第四季度

逻辑 ⁽³⁾	85.6%	87.4%	67.4%
记忆	2.6%	2.4%	23.6%
管理服务	2.2%	2.4%	1.5%
光罩制造, 探测及其它	9.6%	7.9%	7.5%
以客户类别分类	二零零八年 第四季度	二零零八年 第三季度	二零零七年 第四季度
非厂房半导体公司	65.0%	55.1%	49.3%
集成装置制造商	15.2%	26.1%	38.5%
系统公司及其它	19.8%	18.8%	12.2%
以地区分类	二零零八年 第四季度	二零零八年 第三季度	二零零七年 第四季度
北美洲	59.9%	58.6%	44.6%
亚太区 (不包括日本)	36.0%	34.6%	26.4%
日本	1.7%	2.1%	10.4%
欧洲	2.4%	4.7%	18.6%
晶圆收入分析			
各技术占晶圆销售额的百分比 (仅包括逻辑、 记忆及铜接连件)	二零零八年 第四季度	二零零八年 第三季度	二零零七年 第四季度
0.09 微米	11.1%	19.4%	25.3%
0.13 微米	34.4%	25.1%	24.4%
0.15 微米	2.2%	2.0%	5.5%
0.18 微米	32.5%	33.9%	28.3%
0.25 微米	0.6%	0.5%	0.5%
0.35 微米	19.2%	19.1%	16.0%
各逻辑技术占逻辑晶圆销售额百分比⁽¹⁾	二零零八年 第四季度	二零零八年 第三季度	二零零七年 第四季度
0.09 微米	10.9%	19.4%	7.7%
0.13 微米 ⁽²⁾	32.6%	23.2%	21.0%
0.15 微米	2.2%	2.0%	7.7%
0.18 微米	33.7%	35.0%	40.3%
0.25 微米	0.7%	0.5%	0.6%
0.35 微米	19.9%	19.9%	22.7%

附注:

- (1) 不包括 0.13 微米铜接连件
- (2) 代表来自于全流程制造晶圆的销售收入
- (3) 包括 0.13 微米铜接连件

产能 *

厂 / (晶圆尺寸)	二零零八年 第四季度	二零零八年 第三季度
上海厂 (8 吋) ⁽¹⁾	88,000	88,000

北京厂 (12 吋) ⁽²⁾	40,500	36,000
天津厂 (8 吋)	32,000	30,000
每月晶圆装配总产能	160,500	154,000

附注:

*期终每月晶圆计 8 吋等值

- (1) 上海厂目前包括晶圆一厂, 晶圆二厂和晶圆三厂
(2) 北京厂目前包括晶圆四厂, 晶圆五厂和晶圆六厂

付运及使用率:

8 吋等值晶圆	二零零八年 第四季度	二零零八年 第三季度	二零零七年 第四季度
付运晶圆 (包括铜连接件)	323,175	431,660	497,454
使用率 ⁽¹⁾	67.7%	90.5%	94.4%

附注:

(1) 产能使用率按输出晶圆总额除以估计产能计算

- 二零零八年第四季晶圆付运数量较二零零八年第三季的 431,660 片 8 吋等值晶圆减少 25.1% 至 323,175 片 8 吋等值晶圆, 较二零零七年第四季度的 497,454 片 8 吋等值晶圆录得年度降幅 35.0%。
- 二零零八年全年, 晶圆总出货量为 1,611,208 片 8 吋等值晶圆, 录得年度降幅 12.9%; 然而逻辑晶圆出货量较上年增加 24.9%。

2. 详细财务分析

毛利分析

以千美元计	二零零八年 第四季度	二零零八年 第三季度	季度比较	二零零七年 第四季度	年度比较
销售成本	347,114	348,721	-0.5%	360,207	-3.6%
折旧	183,916	165,641	11.0%	161,232	14.1%
其它制造成本	156,446	176,329	-11.3%	190,671	-18.0%
递延成本摊销	5,886	5,886	-	5,886	-
股权报酬	866	865	0.1%	2,418	-64.2%
毛利	(74,636)	27,224	-	35,047	-
毛利率	-27.4%	7.2%		8.9%	

- 二零零八年第四季的销售成本与二零零八年第三季的 348,700,000 元相比,下降 0.5%至 347,100,000 元。
- 二零零八年第四季的折旧增加是由于较低的产能使用率导致折旧费用代替进入存货成本。
- 二零零八年第四季的毛利与二零零八年第三季的 27,200,000 元相比,减少至负 74,600,000 元,二零零七年第四季的毛利为 35,000,000 元。
- 二零零八年第四季的毛利率由二零零八年第三季 7.2%下降至负 27.4%。主要由于产能使用率大幅下降所致。

经营开支分析

以千美元计	二零零八年 第四季度	二零零八年 第三季度	季度比较	二零零七年 第四季度	年度比较
总经营开支	46,445	40,451	14.8%	57,389	-19.1%
研究及开发	12,524	17,838	-29.8%	26,201	-52.2%
一般及行政	16,146	10,761	50.0%	18,820	-14.2%
销售及市场推广	5,843	5,578	4.8%	5,688	2.7%
无形资产摊销	11,564	6,906	67.4%	6,878	68.1%
长期资产的减值损失	967	-	-	-	-
资产处置收入	(599)	(632)	-5.2%	(198)	202.5%

- 二零零八年第四季的总经营开支与二零零八年第三季的 40,500,000 元相比,录得季度升幅 14.8%至 46,400,000 元,主要是由于所获技术协议相关无形资产摊销费用增加所致。
- 二零零八年第四季的研发费用与二零零八年第三季的相比,从 17,800,000 元下降 29.8%至 12,500,000 元,主要由于二零零八年第四季政府补助金增加。剔除政府补贴,研发费用录得季度增幅 8.0%主要是由于与 45 纳米和 65 纳米研发活动相关的费用增加所致。
- 二零零八年第四季的一般行政费与二零零八年第三季的 10,800,000 元相比,增加至 16,100,000 元,是由于二零零八年第三季冲销多计提的律师费用、而二零零八年第四季专业费用增加以及坏帐备拨增加所致。
- 二零零八年第四季的销售费用由二零零八年第三季的 5,600,000 元增加至 5,800,000 元,录得季度升幅 4.8%。

其它收入(支出)

以千美元计	二零零八年 第四季度	二零零八年 第三季度	季度比较	二零零七年 第四季度	年度比较
其它收入(支出)	(4,146)	(15,631)	-73.5%	(1,655)	150.5%
利息收入	1,184	2,542	-53.4%	3,971	-70.2%

利息支出	(7,133)	(11,088)	-35.7%	(11,485)	-37.9%
汇兑收益(损失)	(2,543)	(7,023)	-63.8%	4,613	-
其它,净额	4,346	(62)	-	1,246	248.8%

- 二零零八年第四季的利息费用相对于二零零八年第三季度的减少,主要是由于政府利息补助金增加,此影响部分被由于低资本支出而导致的利息资本化减少所抵消。剔除政府补助金和利息资本化的影响,二零零八年第四季的利息费用相较于二零零八年第三季度增加1,100,000元。
- 二零零八年第四季来自于非经营性活动的汇兑损失由二零零八年第三季度的7,000,000元下降至2,500,000元。合并来自于经营性活动的汇兑收益(单独记录于行政及一般费用下),公司于二零零八年第四季整体录得汇兑亏损400,000元,相较于二零零八年第三季录得汇兑亏损4,600,000元。

折旧及摊销

- 二零零八年第四季的总折旧及摊销费用为207,700,000元,相较于二零零八年第三季的总折旧及摊销费用为197,700,000元。
- 二零零八年的总折旧及摊销费用为805,600,000元,相较于二零零七年的总折旧及摊销费用为754,000,000元。
- 二零零九年的总折旧及摊销费用预期与二零零八年持平,然而总折旧及摊销费用预计在二零一零年下降是由于上海厂的主要8英寸生产机器将于二零一零年到达折旧年限。

流动资金

以千美元计	二零零八年 第四季度	二零零八年 第三季度
现金及现金等价物	450,230	392,881
限制性现金	6,255	3,000
短期投资	19,928	50,646
应收账款	199,372	285,874
存货	171,637	233,022
其它	79,437	72,272
流动资产总计	926,859	1,037,695
应付账款	185,919	301,712
短期借款	201,258	212,600
长期借款的即期部份	360,629	340,355
其它	151,967	177,736

流动负债总计	899,773	1,032,403
现金比率	0.5x	0.3x
速动比率	0.7x	0.7x
流动比率	1.0x	1.0x

二零零八年第四季的现金及现金等价物增加是由于在本季收到来自于战略投资者的新股本资金 165,100,000 元。

资本结构

<i>以千美元计</i>	二零零八年 第四季度	二零零八年 第三季度
现金及现金等价物	450,230	392,881
限制性现金	6,255	3,000
短期投资	19,928	50,646
长期票据即期部分	29,242	29,493
长期票据	23,590	37,762
短期借款	201,258	212,600
长期借款的即期部份	360,629	340,355
长期借款	536,518	692,131
总借款	1,098,405	1,245,086
股东权益	2,764,279	2,721,561
总债务股本比率	39.7%	45.7%

由于二零零八年第四季引入战略投资者的新股本资金以及贷款的偿还，因此公司的债务股本比率有所改善由二零零八年第三季的 45.7%下降至 39.7%。

现金流量概要

以千美元计	二零零八年 第四季度	二零零八年 第三季度
来自于经营活动的现金净额	171, 213	110, 119
来自于投资活动的现金净额	(120, 085)	(162, 773)
来自于融资活动的现金净额	6, 460	(34, 668)
现金变动净额	57, 349	(87, 384)

二零零八年第四季来自于经营活动的净现金流量由二零零八年第三季的 110, 100, 000 元增加至 171, 200, 000 元是由于营运资金使用有所改善。来自于经营活动的现金减去资本开支的净额由二零零八年第三季的-120, 600, 000 元改善至 23, 700, 000 元。

资本开支概要

- 二零零八年第四季资本开支为 56, 000, 000 元。二零零八年的总资本开支为 665, 000, 000 元，相较于早期的市场指引 790, 000, 000 元。
- 二零零九年预期的资本开支总额将约为 190, 000, 000 元。

二零零九年第一季指引

以下声明为前瞻性陈述，此陈述基于目前的期望并涵盖风险和不确定性，部分已于之前的安全港声明中阐明。

- 由于当前的市场环境不明朗，我们无法提供具体的收入指引。估计二零零九年第一季收入可能下降约 50 %
- 经营开支去除汇兑损益约介于 53, 000, 000 元到 56, 000, 000 之间。
- 资本支出预期介于 40, 000, 000 元到 45, 000, 000 元之间。
- 折旧及摊销预期介于 206, 000, 000 元到 208, 000, 000 元之间

近期公布

- 诉讼更新（二零零八年十二月二十四日）
- 股票价格不寻常上升（二零零八年十二月二十四日）
- 中芯国际首批 45 纳米芯片验证成功（二零零八年十二月八日）

- 大唐控股投资 1.72 亿美元于中芯国际（二零零八年十一月十日）
- 根据一般授权发行新普通股及复牌（二零零八年十一月十日）
- 停牌（二零零八年十一月六日）
- 中芯截至二零零八年九月三十日止三个月业绩公布（二零零八年十月二十九日）
- 中芯国际取得美国 32 纳米技术出口许可（二零零八年十月二十七日）
- 中芯国际成功开发出 0.11 微米 CIS 工艺技术（二零零八年十月二十三日）
- 上海高清携手中芯国际 国标芯片助奥运高清成真（二零零八年十月十四日）
- 董事变更（二零零八年十月六日）

上述公布详情请参阅中芯网站。

http://www.smics.com/website/enVersion/Press_Center/pressRelease.jsp

合并资产负债表
(美元)

	截至以下日期止	
	二零零八年 十二月三十一日 (未经审核)	二零零八年 九月三十日 (未经审核)
资产		
流动资产:		
现金及现金等价物	450,229,569	392,881,020
限定用途的现金	6,254,813	3,000,000
短期投资	19,928,289	50,645,536
应收账款, 已扣除拨备分别为 5,680,658 元及 4,697,378 元	199,371,694	285,873,827
存货	171,636,868	233,022,657
预付款项及其它流动资产	56,299,086	52,768,850
厂房、机台及其它固定资产销售应收 款	23,137,764	19,503,560
流动资产合计	926,858,083	1,037,695,450
土地使用权, 净额	74,293,284	74,437,989
厂房及设备, 净额	2,963,385,840	3,106,399,766
购入无形资产, 净额	200,059,106	212,611,259
递延成本	47,091,516	52,977,956
股权投资	11,352,186	11,444,506
其它长期预付款	1,895,337	2,379,500
递延税资产	45,686,470	43,971,049
资产合计	4,270,621,822	4,541,917,475

负债及股东权益

流动负债：

应付帐款

185,918,539 301,711,981

预提费用及其它流动负债

122,173,803 147,725,420

短期借款

201,257,773 212,600,414

长期票据的即期部份

29,242,001 29,492,873

长期借款的即期部份

360,628,789 340,355,129

应付所得税

552,006 517,682

流动负债合计

899,772,911 1,032,403,499

长期负债：

长期票据

23,589,958 37,762,091

长期借款

536,518,281 692,131,401

与特许权协议相关的长期应付款

18,169,006 28,037,163

递延税负债

411,877 621,029

长期负债合计

578,689,122 758,551,684

负债合计

1,478,462,033 1,790,955,183

少数股权

27,881,250 29,401,201

股东权益：

普通股，面值 0.0004 元，法定股份为 50,000,000,000 股，于二零零八年十二月三十一日及二零零八年九月三十日已发行股份分别为 22,327,784,827 股及 18,619,884,481 股。

8,931,114 7,447,954

额外缴入股本

3,489,382,267 3,323,364,177

累计其它综合亏损

(439,123) (199,305)

累计亏损

(733,595,719) (609,051,735)

所有股东权益合计	2,764,278,539	2,721,561,091
总负债及股东权益合计	4,270,621,822	4,541,917,475

合并营运报表
(美元)

截至以下日期止三个月

	二零零八年 十二月三十一日 (未经审核)	二零零八年 九月三十日 (未经审核)
销售额	272, 478, 762	375, 944, 833
销售成本	347, 114, 296	348, 720, 498
毛利	(74, 635, 534)	27, 224, 335
经营费用:		
研究和开发	12, 523, 835	17, 838, 076
一般及行政	16, 146, 415	10, 760, 722
销售和市场推广	5, 843, 252	5, 578, 365
购入无形资产摊销	11, 563, 678	6, 906, 344
所获无形资产减值损失	966, 667	-
来自厂房设备和其它固定资产的销 售所得	(598, 819)	(632, 029)
经营费用总额	46, 445, 028	40, 451, 478
经营亏损	(121, 080, 562)	(13, 227, 143)
其它收入(支出):		
利息收入	1, 183, 576	2, 541, 743
利息支出	(7, 132, 535)	(11, 087, 893)
汇兑亏损	(2, 542, 966)	(7, 022, 913)
其它收入, 净额	4, 346, 182	(62, 216)

其它收入（支出），净额	(4, 145, 743)	(15, 631, 279)
所得税、少数股权及股权投资亏损前净 亏损	(125, 226, 305)	(28, 858, 422)
所得税费用	(745, 310)	(4, 499, 387)
少数股权	1, 519, 950	3, 094, 474
股权投资亏损	(92, 319)	(25, 803)
净亏损	(124, 543, 984)	(30, 289, 138)
每股股份净亏损，基本	(0. 0066)	(0. 0016)
每股美国预托股份净亏损，基本	(0. 3287)	(0. 0814)
每股股份净亏损，摊薄	(0. 0066)	(0. 0016)
每股美国预托股份净亏损，摊薄	(0. 3287)	(0. 0814)
用作计算基本每股普通股 亏损额的股份	18, 947, 602, 493	18, 612, 441, 880
用作计算摊薄每股普通股 亏损额的股份	18, 947, 602, 493	18, 612, 441, 880

合并现金流量表
(美元)

截至以下日期止三个月

	二零零八年 十二月三十一日 (未经审核)	二零零八年 九月三十日 (未经审核)
经营活动:		
净亏损	(124,543,984)	(30,289,138)
净亏损至经营活动所得(所耗)现金净额对账的调整:		
少数股权	(1,519,951)	(3,094,474)
递延税	(1,924,575)	511,663
处置厂房及设备收益	(598,820)	(632,029)
折旧及摊销	193,779,737	188,387,781
购入无形资产摊销	11,563,678	6,931,344
股权报酬	2,358,942	2,368,706
长期票据非现金利息费用	1,480,674	1,522,485
股权投资亏损	92,320	25,803
所获无形资产的减值损失	966,667	-
营运资产及负债的变动:		
应收账款, 净额	86,502,133	(23,455,351)
存货	61,385,789	19,371,201
预付款及其它流动资产	(5,798,142)	(9,608,778)
应付账款	(36,579,576)	(57,377,721)
预提费用及其它流动负债	(15,985,881)	15,422,174

应付所得税	34,327	35,418
经营活动所得现金净额	171,213,338	110,119,084
投资活动：		
购入厂房及设备	(125,145,585)	(220,937,580)
处置厂房及设备所得款项	913,738	3,920,056
出售待售资产所得款项	-	1,004,594
购买所获无形资产	(23,315,762)	(14,670,000)
购买短期投资	-	(154,185,792)
出售短期投资	30,717,248	135,865,909
购买股权投资	-	(1,900,000)
转换限定用途的现金	(3,254,813)	88,129,665
投资活动所耗现金净额	(120,085,174)	(162,773,148)
融资活动：		
短期借款所得款项	57,407,359	84,680,413
长期借款所得款项	39,397,145	-
偿还长期票据支付的款项	(15,000,000)	-
偿还长期借款支付的款项	(174,736,605)	(4,435,051)
偿还短期借款支付的款项	(68,750,000)	(114,987,613)
行使雇员购股权所得款项	42,307	74,176
发行普通股所得款项	168,100,000	-

融资活动（所耗）所得现金净额	6,460,206	(34,668,075)
汇率变动的影晌	(239,821)	(62,231)
现金及现金等价物减少净额	57,348,549	(87,384,370)
现金及现金等价物一期间开始	392,881,020	480,265,390
现金及现金等价物一期间结束	450,229,569	392,881,020

于本公告的日期，本公司董事分别为董事会主席兼独立非执行董事王阳元先生、本公司总裁兼首席执行官兼执行董事张汝京先生、本公司非执行董事周杰先生及汪正纲先生（周杰先生的替任董事）、以及本公司独立非执行董事川西刚先生、陈立武先生、杨雄哲先生及江上舟先生。

承董事会命
中芯国际集成电路制造有限公司
首席执行官
张汝京

中国上海，二零零九年二月五日

* 仅供识别